



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110614001
2011 年 9 月 21 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA/PWR/HVAL 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイヤ変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただきます。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	HPA/PWR/HVAL 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行 : Au(金)線 変更後 : Cu(銅)線			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2012 年 1 月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容 : 弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ)/PWR(パワーマネジメント)/HVAL(ハイボリュームアナログロジック) 一部製品について、現行 Au(金)線ボンディングワイアを使用して製造していますが、機械/電気的特性の向上、同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、Cu(銅)線ボンディングワイアに変更します。ワイヤ径の変更については下記を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

<u>変更内容</u>	<u>現行</u>	<u>変更後</u>
ボンディングワイア	Au(金)線	Cu(銅)線

現行 Au(金)線 ワイヤ径	変更後 Cu(銅)線 ワイヤ径
0.8, 0.96, 1.15, 1.3 (Mil)	0.8, 0.96 (Mil)

理由 : 機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名				
ADS1299CPAG	BQ24760RSBR	PCM5100PWR	TL16PC564BLVIPZG4	TPS658624AZQZT
ADS8555SPM	BQ29441DRBR	PCM5101PW	TLV320AIC30061ZQER	TPS658640ZGUR
ADS8555SPMR	BQ30420DBTR	PCM5101PWR	TLV320AIC30121RHBR	TPS7A8001DRBR
AMC7812SRGCR	BQ30421DBTR	PCM5102PW	TLV320AIC371ZQER	TUSB1310AZAY
BQ20695DBTR	BQ30422DBTR	PCM5102PWR	TLV320DAC33BN1ZQCR	TUSB1310AZAYR
BQ20Z451DBTR-R3	BQ30423DBTR	PCM5121PW	TMDS351PAG	TUSB9260PVP
BQ20Z459DBTR	BQ30424DBTR	PCM5121PWR	TMDS351PAGG4	TUSB9261PVPR
BQ20Z656DBTR	BQ33200ZGVR	PCM5122PW	TPS51211DSCR	VSP6244BZRCR
BQ24707ARGRR	BQ8050DBTR-D1	PCM5122PWR	TPS51211DSCT	VSP6244BZSPR
BQ24707ARGRT	BUF12840AIRGER	PCM5141PW	TPS51212DSCR	VSP6826AZRCR
BQ24707RGRR	BUF12840AIRGET	PCM5141PWR	TPS51212DSCT	X102001IPNP
BQ24707RGRT	CD3240B0ZRPR	PCM5142PW	TPS51220ARTVR	X102211ZAJ
BQ24725RGRR	CDC736RHBR	PCM5142PWR	TPS51220ARTVR/2801	X102211ZAY
BQ24725RGRT	FX002	PSN0904005A3A1ZCBR	TPS51220ARTVT	X102213AZAY
BQ24726RGRR	FX008	PTPS65735RSNR	TPS51640RSLR	X102213BAJ
BQ24726RGRT	HPA00934RGTR	PTPS65735RSNT	TPS51640RSLT	X102213BZAY
BQ24735RGRR	MAX3243CPWR	SN65LVPE502CPRGER	TPS53219RGTR	X102213ZAY
BQ24735RGRT	MAX3243CPWRE4	SN74AVC4T234ZSUR	TPS61187RTJR	X102221ZAY
BQ24740RHDR	MAX3243CPWRG4	SN8045DBTR	TPS65735RSNR	
BQ24740RHDRG4	PCM30701RHBR	SN93045A4ZQZR	TPS65735RSNT	
BQ24747RHDT	PCM5100PW	TL16PC564BLVIPZ	TPS65736RSNR	

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010年3月16日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual device:	TMDS351PAG	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	TQFP/PAG/64	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot 1	Lot2	Lot 3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
**T/C	-55C/125C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C	12/0	12/0	12/0
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 3 月 16 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual device:	TSB43AB23PDT	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	TQFP/PDT/128	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot 1	Lot2	Lot 3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
T/C	-65C/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
T/C	-55C/125C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 3 月 16 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual device:	TSB43DA42GHC	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	UBGA/GHC/196	
Mount Compound:	4073505	Mold Compound:	4203565	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/220C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot 1	Lot2	Lot 3
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**T/C	-55C/125C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-3/220C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 1 月 3 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual device:	BUF16821BIPWP	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	TSSOP/PWP/28	
Mount Compound:	4208458	Mold Compound:	4205443	
Bond Wire:	0.95 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot 1	Lot2	Lot 3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
**T/C	-55C/125C, 500, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
**Thermal Shock	-65C/150C, 500, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
Thermal Path Integrity	JEDEC L-2/260C	12/0	12/0	12/0
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 1 月 3 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual device:	TAS5086DBT	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	TSSOP/DBT/38	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4206193	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot 1	Lot2	Lot 3
**HTOL (Analog)	125C, 1000 Hrs, Vddmax	77/0	77/0	77/0
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
**T/C	-55C/125C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12/0	12/0	12/0
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 1 月 3 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual device:	TLV320AIC3106IZQE	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	BGA/ZQE/80	
Mount Compound:	4111062	Mold Compound:	4205867	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Cu	Solder Ball:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot 1	Lot2	Lot 3
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-55C/125C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C	12/0	12/0	12/0
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 1 月 3 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual device:	TMDS351PAG	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	TQFP/PAG/64	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.95 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot 1	Lot2	Lot 3
**High Temp. Storage Bake	170C, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-55C/125C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C	12/0	12/0	12/0
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 1 月 3 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual device:	VSP6822AZRC	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	JrBGA/ZRC/98	
Mount Compound:	4111062	Mold Compound:	4205867	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Cu	Solder Ball:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot 1	Lot2	Lot 3
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-55C/125C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C	12/0	12/0	12/0
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 1 月 3 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual device:	VSP6825AZRC	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	BGA/ZRC/103	
Mount Compound:	4111062	Mold Compound:	4205867	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Cu	Solder Ball:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot 1	Lot2	Lot 3
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS1230IPW	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	TSSOP/PW/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4206193	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	BQ24703RHD	-	-	
Assembly Site:	MLA	Package/Code/Pins:	VQFN/RHD/28	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	BUF07704AIPWP	-	-	
Assembly Site:	MLA	Package/Code/Pins:	HTSSOP/PWP/20	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205443	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	CDCVF2505PW	-	-	
Assembly Site:	MLA	Package/Code/Pins:	TSSOP/PW/8	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4206193	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年7月7日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	DRV590GQC	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	JRBGA/GQC/48	
Mount Compound:	4111062	Mold Compound:	4205867	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Solder Ball:	SnPb	
MSL:	JEDEC L-2A/235C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2A/235C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年7月7日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	F741900APFB	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	TQFP/PFB/48	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/250C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: **Preconditioning sequence: JEDEC L-3/250C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011年7月7日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN75DP139RGZ	-	-	
Assembly Site:	MLA	Package/Code/Pins:	VQFN/RGZ/48	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN75LVDS84ADGG	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	TSSOP/DGG/48	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4209002	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	THS7303PW	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	TSSOP/PW/20	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4206193	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	76 ball bonds, 3 units min	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	THS7327PHP	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	HTQFP/PHP/48	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205443	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TL16C550DPTR	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	LQFP/PT/48	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	76 ball bonds, 3 units min	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TL16C752BPT	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	LQFP/PT/48	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TLC5930PWP	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	HTSSOP/PWP/24	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205443	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPA5050RSA	-	-	
Assembly Site:	MLA	Package/Code/Pins:	VQFN/RSA/16	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS5130PTR	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	LQFP/PT/48	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS51427ARHB	-	-	
Assembly Site:	MLA	Package/Code/Pins:	VQFN/RHB/32	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS51620RHAR	-	-	
Assembly Site:	MLA	Package/Code/Pins:	VQFN/RHA/40	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS77701PWP	-	-	
Assembly Site:	MLA	Package/Code/Pins:	HTSSOP/PWP/20	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205443	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS77801PWP	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	HTSSOP/PWP/20	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4209002	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TSB12LV21BPGF	-	-	
Assembly Site:	PHI	Package/Code/Pins:	LQFP/PGF/176	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	76 ball bonds, 3 units min	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TSB41AB1PHP	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	HTQFP/PHP/48	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205443	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TSB81BA3EPFP	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	TQFP/PFP/80	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205443	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TVAIC3106IZQER	-	-	
Assembly Site:	PHI	Package/Code/Pins:	BGA/ZQE/80	
Mount Compound:	4111062	Mold Compound:	4205867	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Cu	Solder Ball:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	UCC5696PN	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	LQFP/PN/80	
Mount Compound:	4042504	Mold Compound:	4205442	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 7 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	VSP6825AZRCR	-	-	
Assembly Site:	TAI	Package/Code/Pins:	JrBGA/ZRC/103	
Mount Compound:	4111062	Mold Compound:	4205867	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Cu	Solder Ball:	SnAgCu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 1 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	DRV401AIRGW	-	-	
Assembly Site:	Clark AT	Package/Code/Pins:	VQFN/RGW/20	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Ball Bond Shear	76 balls 3 units min	76/0	76/0	76/0
Bond Pull	76 Wire 3 units min	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 1 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN75DP122ARTQ	-	-	
Assembly Site:	Clark-AT	Package/Code/Pins:	VQFN/RTQ/56	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Ball Bond Shear	76 balls 3 units min	76/0	76/0	76/0
Bond Pull	76 Wire 3 units min	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 1 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TLVDAC32IRHBR	-	-	
Assembly Site:	Clark-AT	Package/Code/Pins:	VQFN/RHB/32	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Cu	Solder Ball Composition:	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	170C, 1000 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-55C/125C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cycles	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C	12/0	12/0	12/0
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 1 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPA2005D1DRB	-	-	
Assembly Site:	Clark-AT	Package/Code/Pins:	VSON/DRB/8	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Ball Bond Shear	76 balls 3 units min	76/0	76/0	76/0
Bond Pull	76 Wire 3 units min	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 1 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS51217DSCR_RFAB	-	-	
Assembly Site:	Clark-AT	Package/Code/Pins:	WSON/DSC/10	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
High Temp Operating Life (Analog)	125C, 1000 Hrs, Vddmax	77/0	77/0	77/0
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Ball Bond Shear	76 balls 3 units min	76/0	76/0	76/0
Bond Pull	76 Wire 3 units min	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 1 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS51217DSC_UMC	-	-	
Assembly Site:	Clark-AT	Package/Code/Pins:	WSON/DSC/10	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Ball Bond Shear	76 balls 3 units min	76/0	76/0	76/0
Bond Pull	76 Wire 3 units min	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 1 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS51621RHA	-	-	
Assembly Site:	Clark-AT	Package/Code/Pins:	VQFN/RHA/40	
Mount Compound:	4207768	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Ball Bond Shear	76 balls 3 units min	76/0	76/0	76/0
Bond Pull	76 Wire 3 units min	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C				